

ダイオード Diodes

■概要

ミニパワー型(2端子)パッケージは、小型電子機器のプリント基板等に直接はんだ付けできるように設計された小型のプラスチックパッケージで、ダイオード等に採用されています。

■特長

- リフロー、フロー両方式の自動はんだ付けが可能。
- 12mmテーピング、横型マガジンなどの包装仕様を用意、各種自動実装機に対応が可能。
- ミニ型では対応できない小電力分野をカバー。

■Description

Mini power type (2-pin) package is a small plastic package designed to be soldered directly to PC board of small electronic equipment and used for diodes, etc.

■Features

- Can be soldered automatically by flow and reflow techniques.
- Packed in 12 mm taping, horizontal type magazine and is applicable to various automatic surface mounting machines.
- Suitable for small power field where a mini type can not be used.

■標準パッケージ定格 Standard Package Ratings

許容接合部温度 $T_{j(max)}$	保存温度 T_{stg}	許容損失 P_D
150°C	-55~+150°C	500mW*1

*1: 銅箔面積 (アノード側 10mm²、カソード側 20mm²、厚み1.6mm)

*1: Copper Area (Anode: 10mm², Cathode: 20mm², t=1.6mm)

注) 一部品種で定格の異なるものがありますので、ご採用時には念のため個別仕様をご確認下さい。

Note) As some types have different ratings, refer to individual ratings before use.

■放熱設計基準(プリント基板の放熱設計は、下表の値をご参考のうえ行って下さい。)

Standard Heat Radiation Ratings (At designing heat radiation of PC board, refer to the ratings tabled below.)

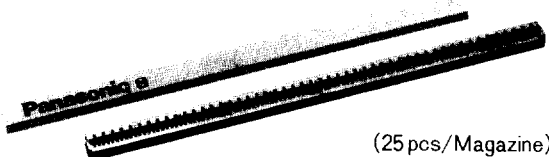
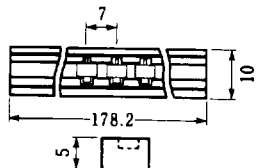
	単 体 Unit	P板*2取付け時(銅箔面積) With PC Board*2 (Copper Area)		
		4mm×4mm	8mm×8mm	12mm×12mm
許容損失 P_D *1(mW)	500	750	1040	1280

*1: $T_a=25°C$ *2: ガラスエポキシ基板 Glass Epoxy Board (厚み $t=1.7mm$, 面積 Area=20mm×20mm)

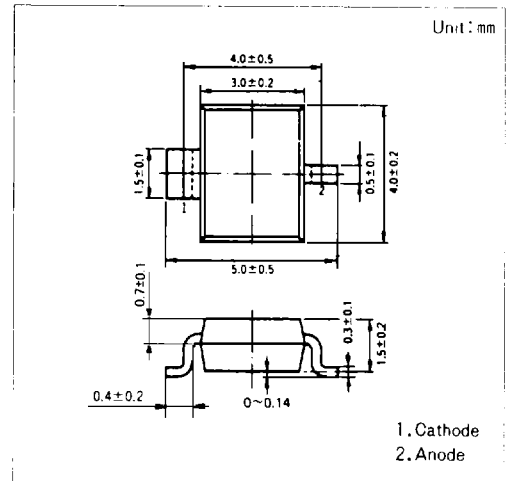
■包装仕様 Packing Style

仕 様 Style	横マガジン Magazine(H)	12mm Taping
梱 包 数 Quantity	25 pcs	1000 pcs

■マガジン仕様 Magazine Style

仕 様 Style	外 観 Outward	主要寸法 Dimensions (mm)
横形マガジン Horizontal Magazine	 (25 pcs/Magazine)	

■外形図 Outline



■推奨パターン寸法 Recommended Land Layout

